

# 深圳市强达电路股份有限公司

## 2025 年度经理工作报告

2025 年，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《经理工作制度》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队开展 2025 年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层向董事会总结汇报 2025 年度相关工作，具体如下：

### 一、2025 年经营管理工作回顾

#### （一）公司经营业绩

2025 年，面对复杂多变的宏观环境与产业竞争格局，公司坚持 PCB 中高端样板和小批量板的定位，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，把握下游应用领域涌现的新机遇，在稳定当前优势业务领域，持续提升工业控制、通讯设备等重点领域业务的基础上，积极布局新兴产业应用领域，全力开拓国内外市场，进一步巩固公司在中高端样板和小批量板领域的地位。

截至 2025 年期末，公司总资产人民币 155,343.05 万元，归属于上市公司股东的净资产人民币 117,202.70 万元；2025 年，公司实现营业收入人民币 95,354.20 万元，同比增长 20.24%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 12,088.75 万元，较上年同期增长 7.31%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 11,815.70 万元，较上年同期增长 20.88%。

#### （二）客户维护与拓展

2025 年中国经济在复杂环境中稳中有进，公司始终将客户价值置于首位，依托长期积淀的稳定品质、及时交付、扎实的技术等优势获得既有客户的信赖，

维护与巩固现有客户的稳定合作关系。在维系现有合作关系高质量运行的同时，公司亦秉持进取精神，积极拓展新客户资源，驱动销售业绩持续向好。

### **（三）产能布局与重点项目建设**

2025年，公司全力推进首次公开发行股票募集资金投资项目——“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目”的建设工作。截至年底，该项目已完成主体建设，引进先进自动化、数字化生产线的前期工作同步展开。该项目的产品主要为高多层板、高密度互连板（HDI），可应用于高端通信、汽车毫米波雷达、智能驾驶控制、人形机器人、Mini LED、半导体测试、物联网（IoT）、低空经济等领域，具有广阔的发展前景。

### **（四）技术研发创新**

为增强竞争实力，公司高度重视自主创新和研发投入，2025年公司研发投入人民币4,822.27万元，研发费用率5.06%。2025年度，公司持续开展存储模块、卫星通讯、AI服务器、激光雷达等应用领域PCB板的研究，例如：应用于存储模块印制电路板技术研究、应用于卫星通讯多次压合埋阻印制电路板技术研究、应用于AI服务器印制电路板技术研究、激光雷达HDI印制电路板技术研究等技术研发项目。截至2025年末，公司共有142名研发人员，服务于公司新产品、新技术的开发和工艺技术的研究，持续提高公司自主研发的知识产权和核心竞争力。2025年，公司先后取得1项发明专利、7项实用新型专利，进一步巩固了公司在相关领域的技术护城河。

### **（五）健全治理结构、加强规范运作**

2025年度，公司恪守《公司章程》及各项规章制度，持续优化内部控制体系及公司治理架构，致力于构建更为坚实的制度基础。坚守“服务电子科技进步，满足广泛快速复杂的挑战，实现员工价值”的企业使命，并围绕“成为电子行业领先企业”的战略愿景，稳步提升内部管理效率，强化成本控制措施，从而推动公司朝着高质量的发展方向稳步前进。2025年，根据新《公司法》要求，公司取消了监事会，其监督职能由董事会下设的审计委员会承接，进一步优化了公司治理架构，提升了决策与监督效率。

## （六）内部管理与降本增效

2025年，为有效应对市场波动带来的经营挑战，公司全面推行精细化管理，以成本管控、资金管理为核心抓手，深挖内部经营潜力，保障公司稳健运营。

成本管控方面，公司强化原材料采购全流程管理，持续优化生产工艺流程，稳步提升产能利用率和产品良率，以高质量、高效率的生产组织模式，有效对冲外部市场波动带来的经营压力。

资金管理方面，公司通过合理调配募集资金及自有资金开展现金管理工作，提高资金使用效率。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为11,888.27万元，同比增长9.29%，现金流保持健康稳健态势。

财务风险控制方面，公司建立了成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，形成了“监测-预警-反馈-改进”的闭环管控流程，为公司经营活动划定安全边界，筑牢风险防控防线。同时，公司持续深化内控体系建设，在强化流程合规性的基础上，重点聚焦内控执行有效性，全面提升公司综合抗风险能力。

## 二、2026年重点工作规划

PCB产业是电子信息产品制造业的基础性产业，受益于工业自动化、5G/6G通信网络、新能源汽车与智能汽车以及半导体和数字经济等领域的快速发展，全球PCB行业开启了新一轮增长周期。根据Prismark数据预测，2026年全球PCB市场仍将保持12.5%的稳健增长；未来五年全球PCB市场将保持稳定增长的态势，预计2030年全球PCB产值预计将达到1,233.48亿美元，2025-2030年复合增长率为7.7%。面对PCB行业发展的机遇和挑战，公司将通过积极开拓市场、加大自主研发投入、强化组织能力建设、建设新厂区以丰富中高端PCB产品型号等措施，进一步提高公司综合竞争力和市场占有率。2026年，公司将重点开展以下工作：

### （一）开拓市场和优化销售服务

2026年，公司将凭借多品种、小批量、快交付的柔性化生产制造优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，积极走访大客户，出台激励措施，争取更多PCB采购订单。同时根据行业发展趋势，及时、适度调整营销策略，努

力开拓国内外市场，加大销售服务力度，力争改善经营状况。

## （二）强化产品研发和技术创新

根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，进行生产工艺改进，开发高附加值的 PCB 产品，努力实现在产品层数、铜厚、高密度互连阶数、电路图形精密度、高频高速等方面工艺技术的创新突破，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。同时，完善公司研发管理体系与研发激励机制，加大对技术研发人员研发和创新成果的激励。此外，引进更多专业人才，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。

## （三）人力资源管理建设

努力建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培育、人员配置、绩效评估、员工激励、员工关怀等关键环节，提升公司人力资源开发与管理的的能力，发挥人才对企业发展的重要支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。公司将进一步通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

## （四）推进项目建设

2026 年，公司将继续以高标准高要求推进子公司南通强达电路科技有限公司（以下简称“南通强达”）“年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”进展，通过南通强达逐步投产扩充公司整体产能和规模，丰富中高端 PCB 产品型号及优化产品结构，从而进一步提高公司产品的市场占有率，稳固公司行业地位，助推公司快速长远发展。

深圳市强达电路股份有限公司

经理：宋振武

2026 年 4 月 10 日